



## 軟金

### §產品說明

軟金專用於印刷電路板打樣(BOND ING)用鍍金工程。超純度鍍金，以中性浴析鍍，可得極低內應力之底層，對鎳污染容忍度高，操作容易，藥液穩定等為其特色。

### §槽液配置

	最適值	範圍
軟金建浴劑	180 克/升	
軟金添加劑	2.2 毫升/每克金鹽	
金鹽(68%)	1.5 克/升	1-12

### §操作條件

緩衝鹽	120 克/升	105-160
比重	1.08 以上	1.08-1.25
溫度	50°C	30-70
pH 值	5.8	5-7
電流密度	0.5 安培/平方公寸	0.1-1
陰陽極面積比	1 : 1	
攪拌	擺動、過濾循環	
加熱器	石英或鐵氟龍	

### §維護與控制



## 1、操作法

每操作 520 安培分鐘，補充金鹽 91 克，軟金添加劑 200 毫升及軟金緩衝鹽 5 磅。

## 2、分析法

### ①金鹽含量

每加金鹽 91 克，加軟金添加劑 200 毫升。

### ②緩衝鹽

依分析添加軟金緩衝鹽

### ③pH

每提升 Ph0.1，加試藥級氫氧化鉀 1.5 克/升。

每降低 pH0.1，加軟金 pH 調整鹽 4.5 克/升。

### ④ 比重

當緩衝鹽添加後，比重仍未足 1.08，則以導電鹽補充。

每提高比重 0.01，加軟金導電鹽 15 克/升。